

01.02.2011

Optimaler Haftverbund von Lötstopplack und Trockenfilm

CONTAG investiert weiter

Der Leiterplattenhersteller CONTAG GmbH in Berlin-Spandau hat im Januar 2011 neue horizontale nasschemische Anlagen installiert und damit die Qualität der Platinen weiter steigern können.

Für einen optimalen Haftverbund von Lötstopplack und Trockenfilmen mit dem Kupfer wird jetzt der bewährte MEC Etch-Prozess genutzt. Hierbei wird die aktive Oberfläche des Kupfers durch eine gezielte Korngrenzenätzung deutlich erhöht.

Darüber hinaus wird in einer zweiten Linie die Kupferoberfläche der Multilayer-Innenlagen vor dem Verpressen mit einer Antitarnish/Primer-Schicht versehen. Dieses Substitutionsverfahren als Ersatz zum klassischen Braun- bzw. Schwarzoxid gewährleistet eine hervorragende Haftung mit den beim Verpressen eingesetzten Prepregs unterschiedlichster Materialtypen.

Die Anlagen selbst kombinieren die Vorteile horizontaler Durchlaufanlagen (hoher Durchsatz, automatische Be- und Entladung, automatisierte Chemie-Dosierungen und damit konstante und reproduzierbare Ergebnisse) mit den Prozessvorteilen der MEC Etch-Chemie.

Für einen universellen Einsatz verfügen die Linien über ein Flexpanel-Transportsystem, das für dünnste Innenlagen-Kerne (50µm) und auch Polyimide konzipiert wurde. Weiterhin wird mit einer abwassersparenden Spülkaskadenkonfiguration der Umweltgedanke der CONTAG GmbH konsequent fortgesetzt.

Der Einsatz der Anlagen wird den Yield bei der Herstellung von Feinstleiterstrukturen (<75µm) quantitativ, sowie die Lötstopplackhaftfestigkeit (auch bei den aggressiven Endoberflächen chem. Sn und chem. Ni/Au) qualitativ verbessern und damit den Herstellungsprozess insgesamt wirtschaftlicher gestalten.

Kontakt:

CONTAG GmbH
Gesellschafter, Geschäftsführer
Herr Andreas Contag
Päwesiner Weg 30
13581 Berlin - Germany
Telefon: +49 (0) 30-351 788-220
Email: contag@contag.de

CONTAG fertigt Leiterplatten-Prototypen in konkurrenzloser Schnelligkeit und hoher Qualität auch in den verschiedensten Sonderausführungen. Seit 30 Jahren ist das Unternehmen ein in der Elektronikindustrie anerkannter Partner. Am Hauptsitz in Berlin wurde 2010 mit 75 Mitarbeitern ein Umsatz von 9 Mio. € erwirtschaftet. Expressfertigung von:

- Ein-, zweiseitige Leiterplatten
- Multilayer bis 24 Lagen
- HDI, Blind- und Buried Via-Technik, Hole Plugging
- Hybrid-Multilayer (z.B. Rogers + FR4)
- Flexible und starr-flexible Leiterplatten
- Impedanzkontrollierte Schaltungen
- Leiterplatten für HF-Anwendungen
- Oberflächen: HAL, chem. Zinn, chem. Ni/Au uvm.
- Sondermaterialien, Mechanische Sonderausführungen, UL-Zertifizierung

PRESS RELEASE